

# 芯片结构特点

## 芯片特点：

- 1、外延衬底为硅，经剥离转移制成垂直结构芯片。
- 2、芯片基板为硅，底部为正电极，顶部为负电极。
- 3、发光层位于芯片上方。
- 4、芯片高度为  $200 \pm 25 \mu\text{m}$ 。
- 5、芯片结构图大致如下：

